

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
A3		REV PER ECR-12-013085			24JULY2012	LW	AC	
B		REV PER ECR-13-017562			14NOV2013	HS	FY	

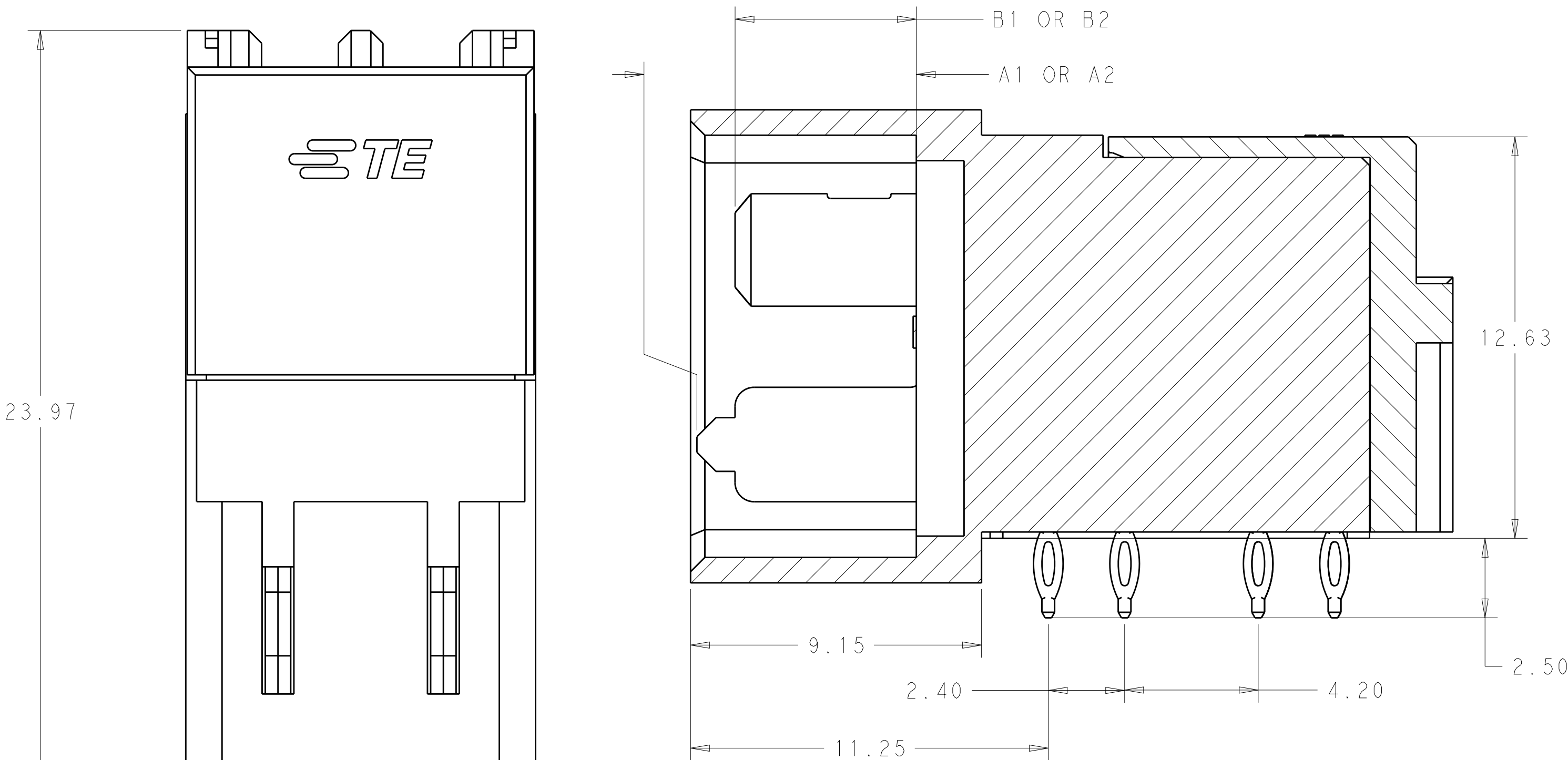
NOTES:
1. MATERIALS:
HOUSING:HIGH TEMP. THERMOPLASTIC GLASS/MINERAL FILLED UL94V-0
TERMINAL:COPPER ALLOY
△ FINISH:
TIN OPTION- GOLD AT CONTACT AREA AND
NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
TIN AT TAIL AREA
TIN-LEAD OPTION- GOLD AT CONTACT AREA AND
NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
TIN-LEAD AT TAIL AREA

△ 3 PCB HOLE SIZE:
-DRILLED HOLE SIZE 0.838MM REF
-COPPER UNDERPLATE 0.03 TO 0.07MM
-TIN/TIN-LEAD SURFACE PLATED FINISHED HOLE SIZE 0.725±0.075MM
OR ORGANIC SURFACE PROTECTANT (OSP) PLATED FINISHED HOLE
SIZE 0.75±0.05MM

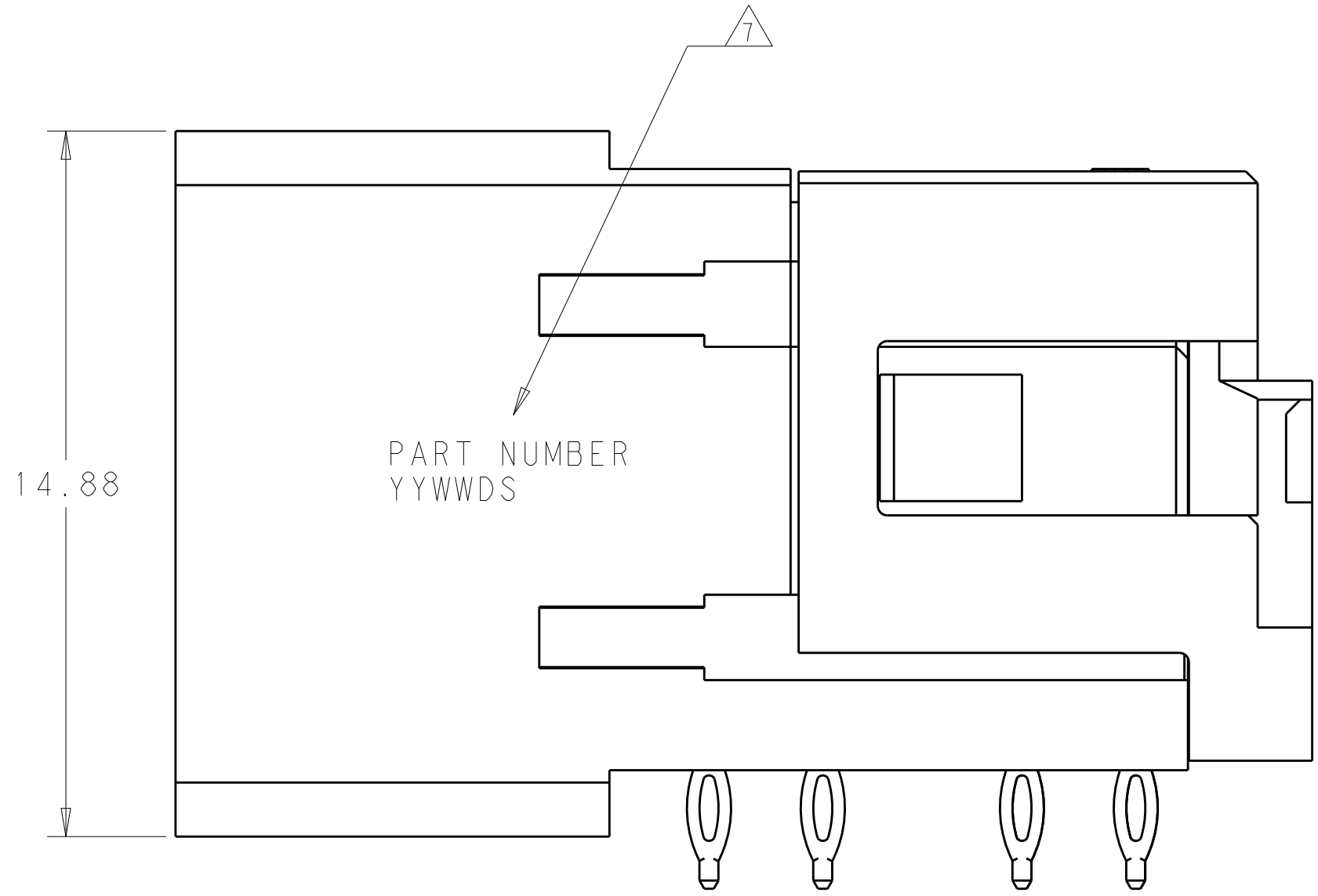
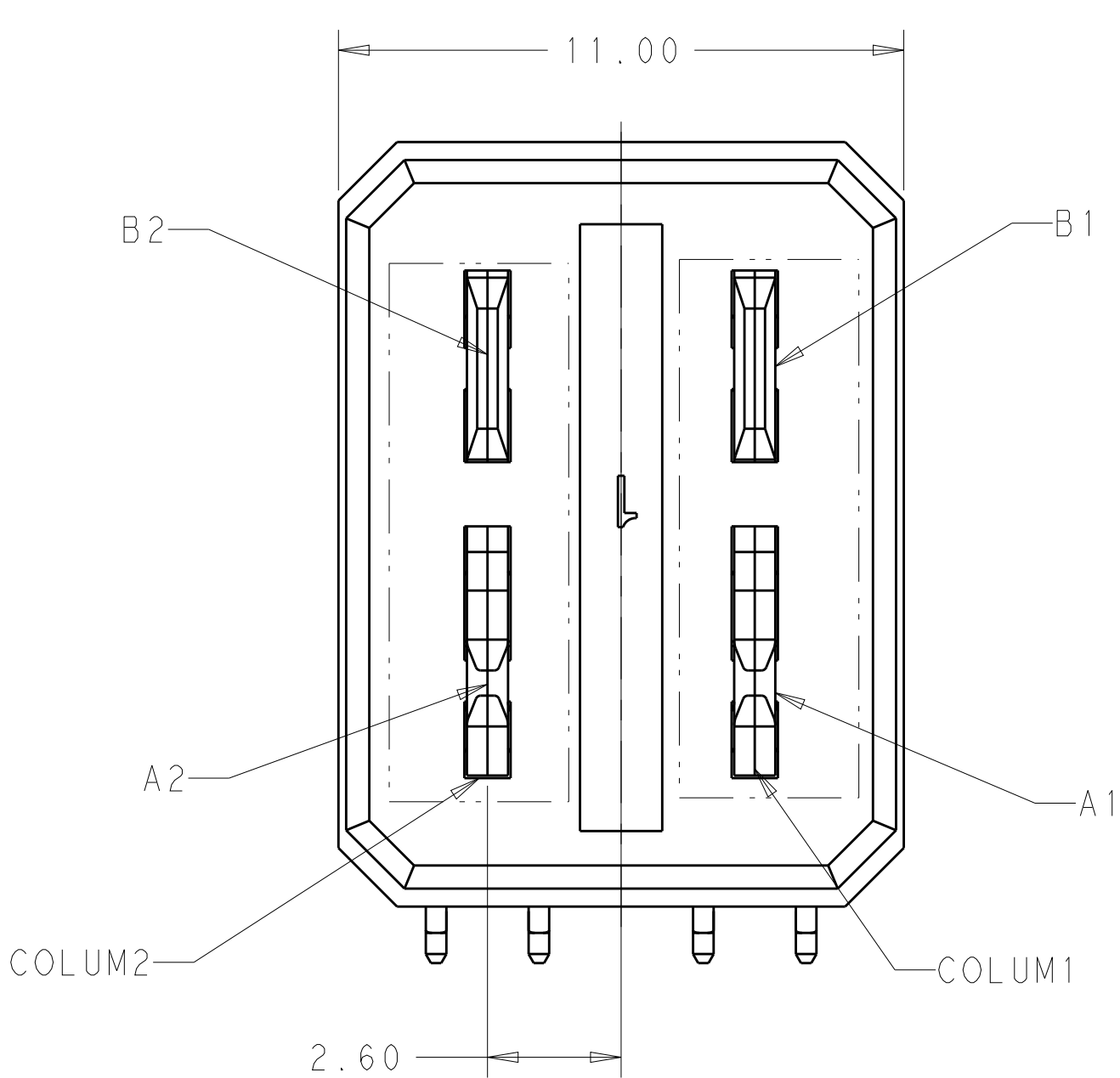
4. CONNECTOR WERE PACKED BY TRAY
5. REFER TO TE'S PRODUCT SPECIFICATION:108-2473
FOR TORQUE FORCE AND RETENTION FORCE

6. MATED WITH 2169806-*

△ 7 PART NUMBER AND DATE CODE AT ASSEMBLY AREA AS APPROXIMATE SHOWN.
ALSO CAN BE OPPOSITE SIDE
△ 8 THERE ARE TWO TYPES OPTION ONE TYPE WITH DOVETAIL
ANOTHER WITHOUT DOVETAIL
△ 9 COMPONENT PLACEMENT ZONE

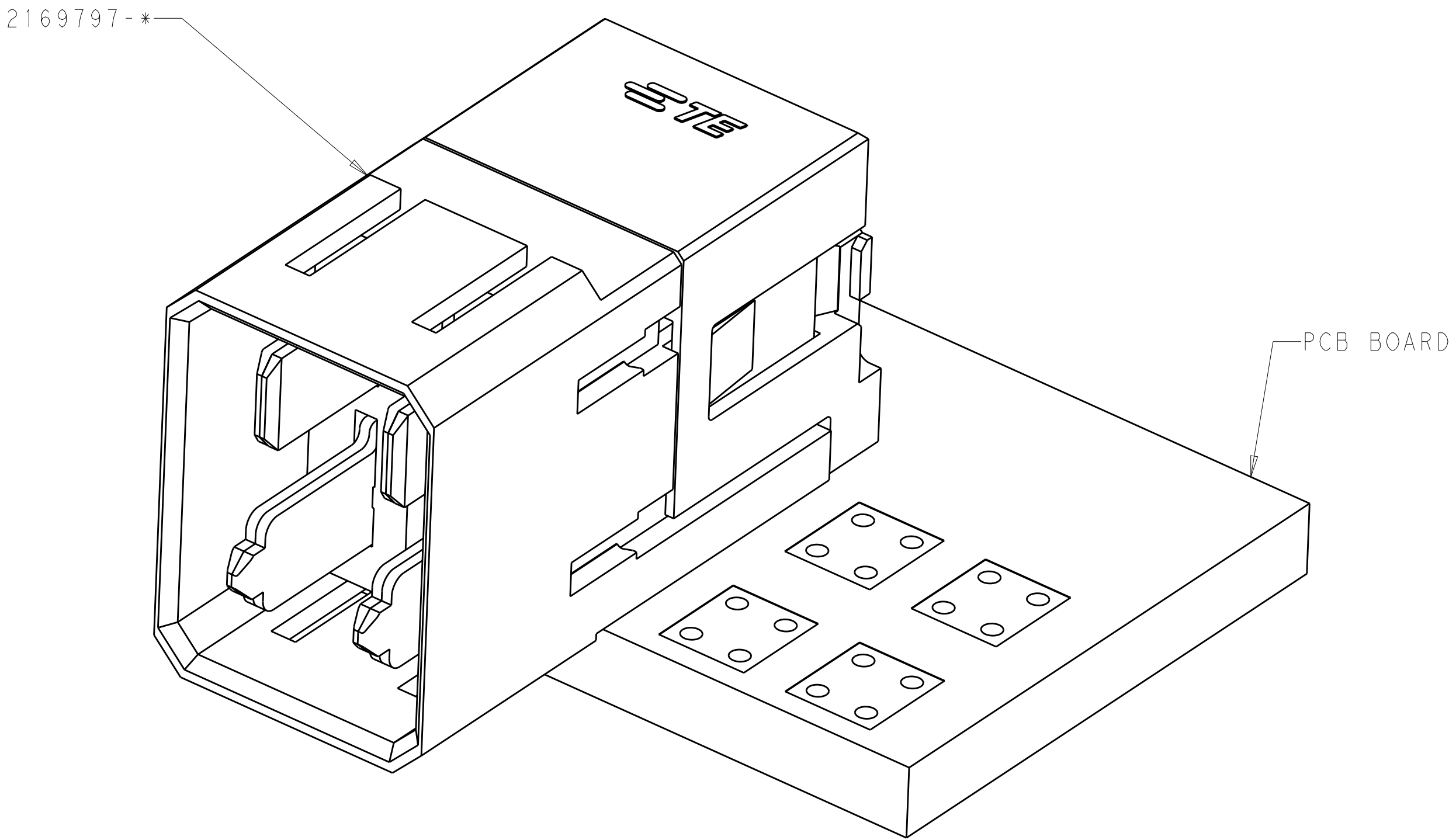


SECTION Z-Z

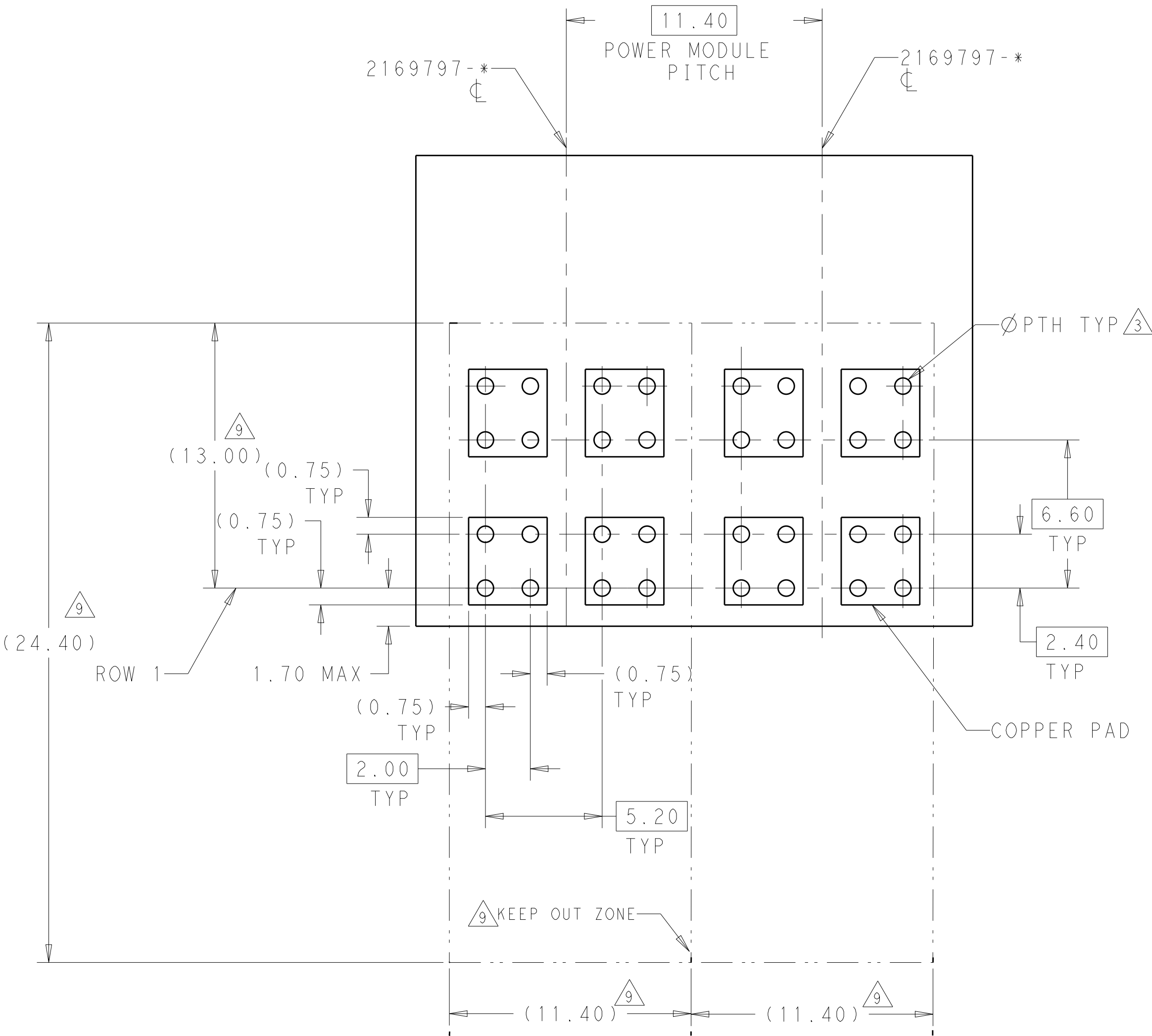


OBSOLETE	TRAY	TIN PLATING	NO DOVE TAIL	6.9	6.9	6.9	6.9	2169797-1
				5.7	5.7	5.7	5.7	2169797-2
				6.9	6.9	5.7	5.7	2169797-3
				5.7	5.7	6.9	6.9	2169797-4
				5.7	6.9	5.7	5.7	2169797-5
			WITH DOVE TAIL	6.9	6.9	6.9	6.9	2169797-6
				5.7	5.7	5.7	5.7	2169797-7
				6.9	6.9	5.7	5.7	2169797-8
				5.7	5.7	6.9	6.9	2169797-9
				PACKAGING	TIN-LEAD PLATING	NO DOVE TAIL	6.9	6.9
	5.7	5.7	5.7				5.7	5-2169797-2
	6.9	6.9	5.7				5.7	5-2169797-3
	5.7	5.7	6.9				6.9	5-2169797-4
	5.7	6.9	5.7				5.7	5-2169797-5
	WITH DOVE TAIL	6.9	6.9			6.9	6.9	5-2169797-6
		5.7	5.7			5.7	5.7	5-2169797-7
		6.9	6.9			5.7	5.7	5-2169797-8
		5.7	5.7			6.9	6.9	5-2169797-9
		PACKAGING	PLATING OPTION			TYP 	B1	B2

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
-	-	SEE SHEET 1		-	-	-	

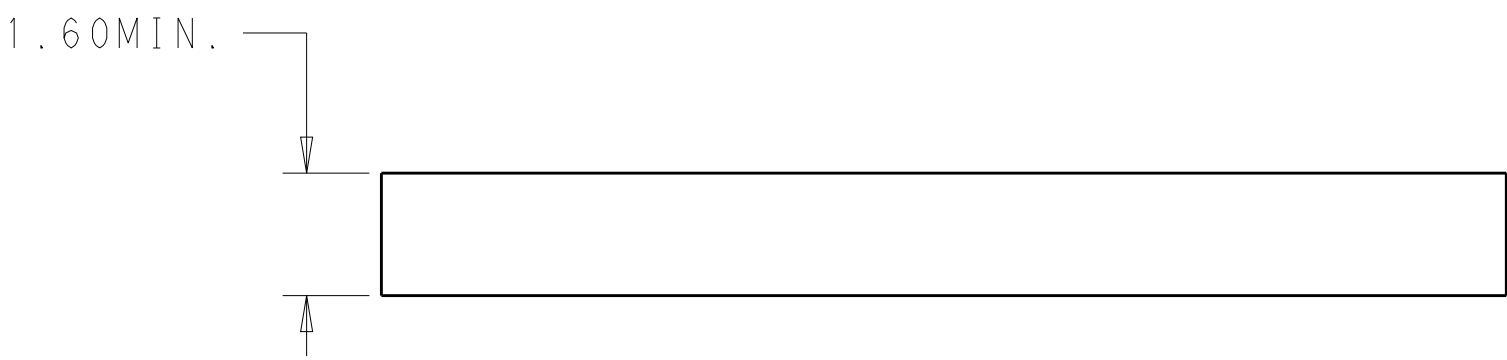
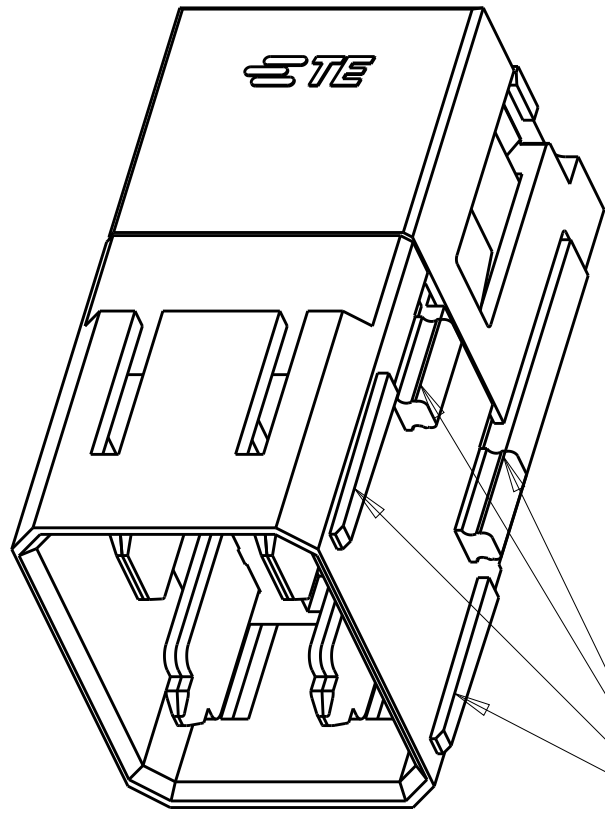
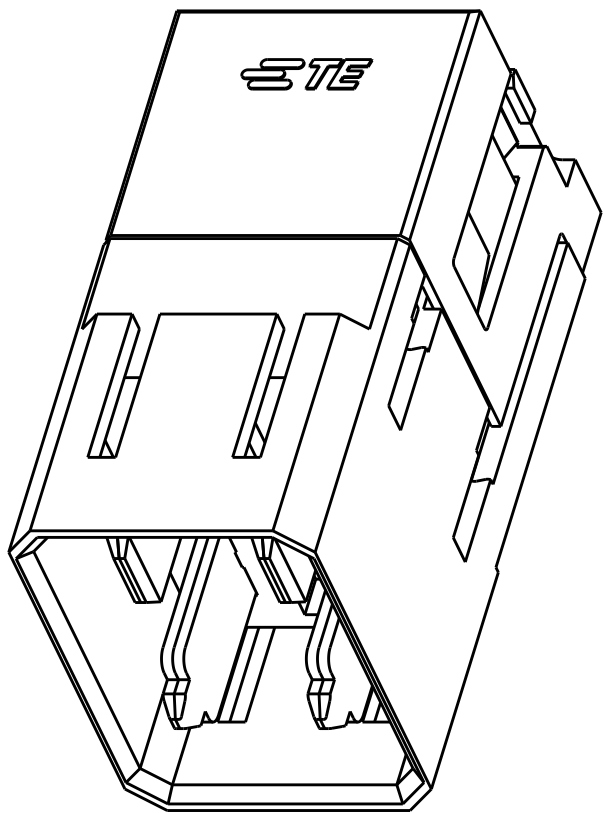


CONNECTOR MATED WITH PCB



NO DOVETAIL ⁸

WITH DOVETAIL ⁸



PCB LAYOUT FOR 3PAIR R/A HEADER POWER MODULE
(COMPONENT SIDE SHOWN)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: LERRY.WANG 05MAY2011	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK: SUNY_ZHAO 05MAY2011		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD: SUNY_ZHAO 05MAY2011	NAME	
	0 PLC ±.1	PRODUCT SPEC	ASSEMBLY	
	1 PLC ±.1	108-2473	IMPACT POWER 3PAIR R/A HEADER	
	2 PLC ±0.25	APPLICATION SPEC	PRESS-FIT	
	3 PLC ±.1	114-32028	SIZE	RESTRICTED TO
	4 PLC ±.1	WEIGHT	A100779C=2169797	-
MATERIAL	FINISH	CUSTOMER DRAWING	SCALE	REV
-	-	-	8:1	B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9